

天水华天科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，严格遵守有关法律法规及公司各项制度的要求，忠实、勤勉地履行职责，有效推动了公司的稳定发展。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、行业竞争格局和发展趋势

1、全球半导体市场发展情况

2025 年全球半导体行业运行呈现出更加健康、可持续的发展态势，行业复苏增长的基础进一步夯实。自 2024 年全球半导体市场进入新一轮复苏上行周期以来，2025 年延续并巩固增长趋势，尤其在人工智能、高性能计算、数据中心建设等需求的拉动下，存储电路市场价格大幅上升，市场需求持续强劲。根据美国半导体行业协会（SIA）数据，2025 年全球半导体销售额达到 7,917 亿美元，同比增长 25.6%，创历史新高。

从产品类别来看，逻辑电路产品得益于人工智能、高性能计算等领域对 CPU、GPU 等集成电路产品的强劲需求，销售额实现同比 39.9% 的大幅增长，达到 3,019 亿美元，继续成为半导体市场最大的产品类别；存储电路产品在人工智能技术对高带宽存储（HBM）需求快速增长以及存储集成电路龙头企业产能扩张滞后于需求增长等因素的影响下，DRAM 和 NAND 等存储电路产品供需紧张，价格上涨带动销售额实现同比 34.8% 的增长，达到 2,231 亿美元。

展望 2026 年，人工智能、物联网等新兴技术以及机器人、新能源汽车、商业航天等产业的快速发展将持续推动集成电路需求快速增长，其中存储与逻辑电路产品仍为增长主力，增速或均超 30%。根据美国半导体行业协会（SIA）预测，2026 年全球半导体销售额将持续攀升，有望达到约 1 万亿美元。

2、我国集成电路产业发展情况

2025 年，我国电子信息制造业整体保持快速发展，企业效益稳步向好，成为工业增长的重要支撑。规模以上电子信息制造业增加值同比增长 10.6%，增速分别高出同期全国工业、高技术制造业 4.7 和 1.2 个百分点。集成电路行业作为

核心细分领域，增长更为突出，行业增加值同比增长 26.7%，增速大幅领先电子信息制造业，领跑工业及高技术制造业，成为推动电子信息产业升级、高端制造提速的关键增长引擎。

2025 年，我国半导体销售额首次突破 2,000 亿美元整数关口，超过 2,100 亿美元，该规模刷新历史纪录，并占全球半导体销售规模比重保持三成左右。根据国家统计局数据，2025 年我国集成电路产量为 4,842.8 亿块，同比增长 10.9%。根据中国半导体行业协会集成电路设计分会数据，2025 年我国集成电路设计业销售额为 8,357.3 亿元，同比增长 29.4%。从销售额过亿元的设计企业看，2025 年达 831 家，较 2024 年增加 100 家，同比增长 13.7%。集成电路设计业的快速发展，为集成电路制造和封装测试带来了广阔的发展空间。

3、封装测试产业发展情况

集成电路行业因其技术复杂，产业结构高度专业化，按加工流程分为集成电路设计、芯片制造、集成电路封装测试。对于集成电路垂直分工的商业模式，由设计公司完成集成电路设计后委托给芯片制造厂生产晶圆，再委托封测厂进行封装测试，然后销售给电子整机产品生产和相关应用企业。

从全球市场来看，封装测试行业市场集中度较高且较为稳定，行业前十大企业由中国台湾、中国大陆和美国企业所占据，近年来全球前十大企业市场份额达到 75%以上，而且有进一步提高的趋势。

根据 ChipInsights 数据，2025 年全球封测（OSAT）市场规模达 3,332 亿元，创历史新高，其中中国封测企业（含中国台湾企业）市占率为 66.02%。封装测试作为半导体产业链后端核心环节，其重要性持续提升。在后摩尔时代，先进封装已成为超越摩尔定律、提升系统性能的关键路径之一。先进封装技术不单纯依赖制程微缩，而是通过高密度集成和微型化设计，实现芯片性能提升与成本优化，契合集成电路向更小尺寸、更高性能、更低功耗演进的发展趋势。在 HPC、AI 等应用的强力驱动下，基于 RDL、Bumping、TSV、Wafer 等核心工艺的倒装封装、晶圆级封装、系统级封装以及 2.5D/3D 封装等先进封装市场占比持续扩大，推动先进封测产值不断提升。

在我国集成电路产业链中，集成电路设计、制造能力与国际先进水平差距不断缩小，封装测试技术逐步接近国际先进水平，封装测试业是唯一能够与国际企

业全面竞争的产业，包括公司在内的国内主要封装测试企业在先进封装领域进展显著，在技术水平上已经和外资、合资企业基本同步，竞争实力逐渐增强。公司为国内领先的集成电路封装测试企业，产业规模居全球集成电路封测行业前十大之列。

4、国家支持集成电路产业发展的相关政策

集成电路产业的技术水平和发展规模已成为衡量产业竞争力和综合实力的重要标志，国家明确将集成电路产业的发展上升至国家战略，并连续出台了一系列产业政策。国务院 2020 年 7 月出台的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》，从财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场应用政策、国际合作政策八个方面给予集成电路企业相应的政策支持。2021 年 3 月公布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》指出，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目，将集成电路作为原创性引领性科技攻关产业之一。党的二十大报告强调，推动战略性新兴产业融合集群发展，构建新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保等一批新的增长引擎。中共中央 2024 年 7 月审议通过的《关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》指出，抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》指出，完善新型举国体制，采取超常规措施，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。

在国家出台相关鼓励集成电路产业发展的政策后，我国主要集成电路产业聚集地则根据各自情况出台了省、市集成电路产业发展政策。随着国家及地方支持政策的出台和实施，将有力促进我国集成电路产业发展，集成电路产业将迎来新的发展机遇。

二、2025 年度公司经营情况

2025 年，在集成电路行业快速发展的大背景下，公司订单同比大幅增

长，各季度营业收入均实现正增长，并于四季度实现新高，公司经营效益和盈利能力稳步提升。2025年，公司共完成集成电路封装628.80亿只，同比增长9.33%，晶圆级集成电路封装211.99万片，同比增长20.16%；完成营业收入172.14亿元，同比增长19.03%，实现归属于上市公司股东的净利润7.11亿元，同比增长15.30%。2025年公司主要工作开展情况如下：

1、深入践行以客户为中心的发展理念，牢牢把握新能源汽车与人工智能产业快速发展的战略机遇，聚焦国内CPU、GPU等重点客户拓展与产业化落地，持续强化汽车电子产品战略方向。报告期内，公司进一步优化战略客户管理机制，集中优势资源提升客户服务水平，全年战略客户销售目标完成率达108%；同时，公司不断细化全流程价格管理，持续推进金线、基板等材料价格与封装产品价格联动机制，维持公司封装产品利润水平。

2、坚持先进封装技术的研发与产业化，加快推进板级封装、2.5D等平台技术研发，顺利完成ePoP/PoPt高密度存储器及面向智能座舱与自动驾驶的车规级FCBGA封装技术的开发，同时持续推进CPO封装技术研发。为满足Bumping、WLP、FOPLP等先进封装业务的发展需要，华天江苏与盘古半导体积极补充管理、技术与工程团队，目前两家公司均已进入生产阶段。

公司于报告期内获得授权专利48项，其中发明专利44项。

3、不断推进质量文化建设，全面开展精益六西格玛管理，通过质量绩效评审、质量异常管控、落地稽核与持续改善等工作，逐步构建集团化客户质量管理体系，加强业务连续性管理，强化制程稳定性，推动质量管理体系高效运行与持续改进，不断提升封装产品质量与客户满意度。

4、围绕“减少人工干预、提升执行一致性”的目标，开展自动化与信息化融合，对比公司及相关子公司自动化建设的优势和短板，总结自动化项目的实施成效与推广经验，加速推进公司智能产线建设，同时，通过材料与设备降耗、国产化应用、效率优化及优秀实践推广等举措，降低生产成本，持续提升公司自动化水平和生产效率。

5、2025年9月，公司启动收购华羿微电事项，截至本报告披露日，收购华羿微电事项已通过公司董事会和股东会审议，并获得深圳证券交易所受理。收购华羿微电将延伸功率器件研发设计与自有品牌业务，拓宽封装

测试业务布局，有利于提升综合竞争力与盈利水平。

6、报告期内，公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期等待期届满，股票期权开始行权。股票期权激励计划的开展，充分调动了公司核心技术和业务人员的积极性、创造性及责任感，促进公司经营目标的实现。

三、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 10 次会议，会议情况如下：

1、2025 年 2 月 19 日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于建立<市值管理制度>的议案》。

本次会议决议公告已于 2025 年 2 月 20 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、2025 年 3 月 29 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过《总经理 2024 年度工作总结和 2025 年度工作计划》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年年度报告及摘要》《2024 年度财务决算报告》《2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案》《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2024 年度）》《2024 年度内部控制评价报告》《关于聘请会计师事务所的议案》《关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于公司第八届董事会董事候选人的议案》《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的议案》《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

本次会议决议公告已于 2025 年 4 月 1 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、2025 年 4 月 22 日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举了公司第八届董事会董事长、董事会各专业委员会委员及主任委员，聘任了公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表。

本次会议决议公告已于 2025 年 4 月 23 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、2025年4月29日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过公司《2025年第一季度报告》。

本次会议仅审议公司《2025年第一季度报告》一项议案，未披露本次会议决议。《2025年第一季度报告》已于2025年4月30日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、2025年5月6日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。

本次会议决议公告已于2025年5月7日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、2025年8月1日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

本次会议决议公告已于2025年8月2日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、2025年8月18日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过公司《2025年半年度报告全文及摘要》《董事会关于募集资金存放、管理与使用情况的专项报告（2025年半年度）》。

本次会议决议公告已于2025年8月19日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、2025年9月12日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

本次会议决议公告已于2025年9月13日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、2025年10月16日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》《关于本次重组

构成关联交易的议案》《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》《关于本次交易不构成重组上市的议案》《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》《关于本次重组相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案》《关于本次重组前12个月内购买、出售资产情况的议案》《关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内波动情况的议案》《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》《关于暂不召开股东大会的议案》。

本次会议决议公告已于2025年10月17日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、2025年10月27日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过公司《2025年第三季度报告》《关于变更注册地址、注册资本和股份总数并修订<公司章程>及其附件的议案》《关于建立、修订公司相关管理制度的议案》《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

本次会议决议公告已于2025年10月28日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二）股东大会召集及决议执行情况

2025年公司董事会召集了2次股东大会，会议具体情况如下：

1、2025年4月22日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告及摘要》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配及资本公积转增股本预案》《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2024年度）》《关于聘请会计师事务所的议案》《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》，选举肖胜利、崔卫兵、刘建军、肖智轶、张铁成、张昊玳为公司第八届董事会非独立董事，选举

于燮康、徐焕章、何晓宁为公司第八届董事会独立董事，选举张利平为公司第八届监事会非职工代表监事。

2、2025年11月21日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更注册地址、注册资本和股份总数并修订<公司章程>及其附件的议案》《关于建立、修订公司相关管理制度的议案》。

以上议案董事会均按照股东大会决议积极予以贯彻执行。

（三）董事会各专业委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略发展委员会四个专业委员会。报告期内，董事会各专业委员会根据《上市公司治理准则》和公司董事会各专业委员会会议事规则，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了有力的支持。报告期内，各专业委员会履职情况如下：

报告期内，审计委员会选举了审计委员会主任委员，审议了公司募集资金存放与使用情况、财务报表、内部日常审计、外汇套期保值、聘请会计师事务所以及专项审计等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，并认真听取了审计办公室2024年工作总结及2025年工作计划，对公司财务状况和经营情况进行了有效的指导和监督。审计委员会关注2024年年报审计工作安排及审计工作进展情况，积极与年审注册会计师进行沟通，规范完成了2024年财务报表的审计工作。同时，审计委员会对审计机构2024年度审计工作进行了评价和总结，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年度会计报表的审计工作中尽职尽责，遵守会计和审计职业道德，具备专业能力，恪守独立性和保持职业谨慎性，较好地完成了对公司2024年度财务报表的审计工作。

报告期内，薪酬与考核委员会选举了薪酬与考核委员会主任委员，审议了公司高级管理人员2024年度履职和薪酬情况、2023年股票期权激励计划相关事项、修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等。

报告期内，提名委员会对第八届董事会董事候选人、高级管理人员任职资格进行审查，选举了提名委员会主任委员，对公司高级管理人员结构及是否符合公司经营管理需要进行了评议。

报告期内，战略发展委员会选举了战略发展委员会主任委员，审议了公司2025年度经营计划、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项等。

（四）董事履职情况

公司全体董事的任职条件均符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，其中独立董事具备履职所需的专业知识，均满足独立性要求，不存在影响独立性和独立履职的情形。全体董事忠实、勤勉地履行董事职责，密切关注公司经营情况、财务状况和重大事项的进展，各位董事在审议董事会各项议案和决策过程中，以及全体独立董事出席独立董事专门会议审议相关事项时，始终坚持科学、审慎的原则，充分考虑公司与股东的具体情况与利益诉求，尽职尽责地提供专业分析和意见建议，推动了董事会规范运作和公司各项生产经营工作的正常开展。

董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定对董事进行绩效评价。

四、2026年度公司经营计划

根据行业特点和市场预测，2026年度公司生产经营目标为全年实现营业收入200亿元。

2026年主要开展以下工作：

1、继续发挥销售龙头带动作用，把握人工智能、具身智能产业发展趋势，聚焦存储、CPU/GPU/AI、CPO及汽车电子等重点市场，着力提升先进封装技术市场占比。持续深化客户服务与战略客户开发导入，集中资源保障封测订单高效交付，不断提升客户满意度，夯实订单稳定增长基础，推动市场份额持续巩固提升。

2、坚持以市场为导向的技术创新，加速推进先进封装技术与产品的研发及量产转化。重点加快2.5D技术平台产品量产进程，着力深化Memory、大尺寸FCBGA、SiP及汽车电子等重点领域的客户开发，持续扩大业务规模；同时加快推动CPO

技术研发落地，积极构建相关产品矩阵，为后续产业化应用与市场导入奠定坚实基础。

3、持续提升质量管理水平，强化全员全面质量管理思想和意识，不断完善封装产品分层级管控方法，建立科学有效的质量管控系统，推动公司封装产品质量水平稳步提升。

4、持续开展精益生产和降本增效工作，总结梳理可推广的最佳实践，通过优化工艺流程、引入生产自动化等措施，不断挖潜设备效率与管理效能，不断提升公司生产效率。

5、积极推进收购华羿微电相关工作，延伸功率器件业务，完善封装业务布局，推动公司规模稳步扩大。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日